公司代码:688403 转债代码:118049 公司简称:汇成股份 债简称:汇成转债

合肥新汇成微电子股份有限公司

【2025】年度报告摘要

第一节重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“四、风险因素”相关内容。请投资者注意投资风险。

3、公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2025年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股,截至2025年3月18日,公司总股本897,840,630股,以此为基数计算,合计拟派发现金红利44,892,031.50元(含税),占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为29.91%。

如在年度报告披露之日起至实施股权登记日期间,因可转债转股/股权激励授予/股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等发生股本总数发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整股利分配总额。如后续总股本发生变化,公司将在权益分派实施前另行公告具体调整情况。

公司2025年度利润分派预案已经公司第二届董事会第十七次会议审议,尚需提交公司2025年年度股东会审议,实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。

8、公司存在优先股的情况

□是√否 □否

9、公司存在表决权差异安排

□是√否 □否

10、是否存在公司的理特殊安排等重要事项

□是√否 □否

第二节公司基本情况

1、公司简介

11、公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	汇成股份	688403	不适用

12、公司存托凭证简况

□适用 √不适用

13、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁丽	王赞
联系地址	安徽省合肥市新站高新技术开发区合肥综合保税区内项王路8号	安徽省合肥市新站高新技术开发区合肥综合保税区内项王路8号
电话	0551-67139968-7099	0551-67139968-7099
传真	0551-67139968-7099	0551-67139968-7099
电子信箱	zhengquan@unionsemicon.com.cn	zhengquan@unionsemicon.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

21、主要业务、主要产品或服务情况

公司主营集成电路先进封装测试服务,所封测的产品主要用于显示驱动芯片,并持续布局存储芯片封装测试领域。公司直接客户主要为显示驱动芯片设计企业/晶圆代工厂/IDM厂商,客户群体覆盖国内外主流芯片设计企业,客户主要为LCD面板显示驱动芯片(DDI)、触控与显示驱动集成芯片(TDDI)、AMOLED面板显示驱动芯片等;按照终端应用场景,主要分为智能手机、高清电视、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴、汽车电子、电子标签等类别。公司显示驱动芯片封装测试制程服务具体情况如下:

工艺制程	具体介绍	功能特点	应用范围或领域
Bumping	凸块制造是指通过溅镀、曝光显影、电镀和蚀刻等制程,在晶圆的焊垫上制作凸块,可达到高效的电性传输,替代了传统封装中的导线键合。公司凸块制造工艺可实现凸块间最小间距最小至18μm,单片12吋晶圆上制造的千万颗凸块	通工艺可大幅缩小芯片模组的体积,具有密度大、散热佳、高可靠性等优点	主要应用于显示驱动芯片领域,适用于覆晶封装(FC)技术
CP	晶圆测试是指用探针与晶圆上的每个晶粒接触进行电气连接以检测其电气特性,对于检测不合格的晶粒用点墨进行标记,在切割环节被淘汰,不再进行下一个制程	通工艺不仅可以预测出合格的芯片,直接计算出良率,还可以减少后续不必要的操作,有效降低整体封装的成本	是大多数封装工艺必经的前道工序
COG	玻璃覆晶封装是指将芯片上的金凸块与玻璃基板上的引脚进行接合并利用胶质材料进行密封隔绝的技术,由于其广高良好稳定性,而被成熟应用于高清电视、手机等产品	是目前较为传统的屏幕封装工艺,也是最具性价比的解决方案,但由于芯片直接放置在玻璃基板上,占用较大空间,故屏占比不高	主要应用于小尺寸面板,如手机、平板电脑、数码相机等
COF	薄膜覆晶封装是指将芯片的凸块与卷带上的内引脚接合,之后由面板或模组厂商等将外引脚与玻璃基板接合	具有高密度、高可靠性、轻薄短小、可弯曲等优点,有利于缩小屏幕边框,提高屏占比	主要应用于电视等大尺寸面板和全面屏手机等

22、主要经营模式

1、盈利模式

公司属于集成电路行业的封装测试服务环节企业,采用行业惯用的OSAT(半导体封装测试外包)模式,在OSAT模式下,公司业务不涉及集成电路设计环节和晶圆制造环节,专门为集成电路设计公司提供封装测试服务。公司根据客户需求,通过工艺设计、利用封装测试设备、自行购买封装测试原辅料,对客户提供的晶圆进行凸块制造、晶圆测试、研磨、切割、封装等一系列的定制化精密加工及成品测试服务。公司通过为客户提供服务并收取加工服务费的方式获取收入和利润。

2、采购模式

公司的采购模式为按需采购,由物料采购部门统计生产有关的物料耗材需求并编制需求单,根据需求单向供应商下达采购订单并签约。对于主要采购材料,公司一般会与供应商签订框架协议,约定年度协议价格的测试价比例、单价、付款方式等。采购材料根据合同要求付款,由采购部门根据合同记录的付款申请单、经系统签核后,到期支付款项。采购材料到货后由相关部门进行验收,品质部门顺次对应商提供的出货检测报告后进行分类抽检,检验合格后在系统中制作验收单,经系统签核后确认收货。

公司建立了供应商认证准入机制和考核机制,以保证供应质量及供应稳定性。公司仅向评估合格的供应商进行采购,评估内容包括供应商资质、材料质量、采购效率等,并且在采购的过程中持续考核其产品质量及服务等方面,对质量问题实时反馈并要求整改。

3、生产模式

公司目前采用行业普遍的“客户定制,以销定产”受托加工生产模式,即由客户提出需求并提供晶圆、卷带等制造材料,公司自行外购电镀液、金属靶材等封装测试辅料,按着相关客户需求完成相应工艺制程,而后将成品交付给客户或指定客户。

公司专注于提供高端封装和测试服务,拥有专业的工程技术和生产管理团队,并配备了专业的高精度自动化生产设备,可以为客户提供多样化、针对性、差异化又性价比的封装测试服务。

4、销售模式

公司采用直销模式进行销售,并制定了相应的销售管理制度。

作为集成电路封装测试企业,公司需要对客户技术需求进行工艺验证、验证通过后方能与客户开始合作。公司在获取客户具体订单后完成封装测试服务,并按照客户要求提供交付物,公司根据客户要求的付款条件定期开具的结算单,并在约定的付款时间内完成结算。

基于定制化的受托加工模式,公司的销售定价主要由自行采购的材料成本以及根据客户对工艺的要求协商达成的加工服务费共同构成。由于每个客户的芯片封装测试方案都具有定制化、个性化的特点,通常情况下,公司单独报价,而公司在报价时需结合并结合市场供需行情等因素予,与客户协商确定。后续在合作期客户可向公司下达需求订单以调整。

凸块制造的定价基于耗用的原材料成本及相应的加工服务费确定,晶圆测试、玻璃覆晶封装与薄膜覆晶封装主要基于不同芯片的具体工艺要求,综合考虑加工设备类型、加工时长及功能测试需行情的供求下,与客户协商确定。

5、研发模式

公司主要通过自主研发的模式持续对先进封装测试工艺进行研发活动,存实已有技术基础的同时进一步提高技术壁垒,并保障研发项目成功投产转化。

公司主要基于客户需求及技术方案的最新趋势,进行相应的研发投入,公司制定的研发流程主要包括项目调研、项目立项、工艺设计与开发、样品试制和研发结项等阶段,具体情况如下:

(1)项目调研

公司的研发项目主要来源于以下渠道:一是研发中心会定期调研行业发展趋势,结合公司发展规划及现有技术基础,选择相似的新技术、新工艺的研发立项;二是业务营销部在市场开拓过程中会有意收集客户需求信息,形成对市场需求的综合判断,针对市场需求集中的新产品提出立项建议。

(2)项目立项

研发中心在项目调研或收到立项建议后,将先进行初步论证,如初步论证可行,则会公司分管理层共同讨论立项提议,根据下发产品、工艺的技术指标、技术难点、成本效益等内容进行评估,确定具体研发内容,进而对资源配置、执行周期、项目人员等进行部署,形成研发项目立项书后正式启动项目研发工作。

(3)工艺设计与开发

公司根据项目立项书及技术可行性分析的要求,开展设计开发工作。由研发中心设立专项课题小组,积极调动各种资源以配合专项课题小组的活动。工艺设计开发流程,将召开评审会议,对项目取得的研发成果予以评定。专项课题小组根据会议评审结果,对项目设计与开发方案予以进一步修改,完善,并及时反馈给研发中心相关负责人。

(4)样品试制

专项课题小组会同生产制造部根据评审会议确定的技术参数和开发方案进行样品试制,专项课题小组辅以监督和技术指导,试制完成的样品品质保障部进行质量检测,并提交给研发中心相关负责人。

(5)研发结项

在验证合格后,研发中心将召开项目评审会,对样品的性能参数予以全面评估。评审会通过专项课题小组提交研发结项报告,项目研发工作结束。

23、所处行业情况

1、行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)所处行业

公司主营业务为集成电路的封装测试,根据《国民经济行业分类》(GB/4754-2017),公司属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”之“C3973 集成电路制造”,根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》,公司属于“1 新一代信息技术产业”之“1.2 电子核心产业”之“1.2.4 集成电路制造业”,是电子核心产业中集其技术能量与资金密集属性的关键环节。

(2)行业发展阶段及基本特点

自上世纪50年代集成电路诞生以来,集成电路封装测试行业随着集成电路设计和制造技术的发展而演进,已历经了60余年的发展过程,大致可以划分为不久发展阶段:20世纪70年代以前属于集成电路封装技术发展的第一阶段,以通孔插装型封装为主;20世纪90年代以前属于第二阶段,以表面贴装型封装为主;20世纪90年代以后,以芯片级封装(CSP)、晶圆级封装(WLP)、球栅阵列封装(BGA)为代表的面系阵列型封装技术逐渐成熟,进入封装技术发展的第三阶段;20世纪末开始,以晶圆级凸块封装(Bumping)、系统级封装(SiP)等技术为主流的封装进入第四阶段;进入21世纪之后,倒装封装(FC)、晶圆级系统封装-硅通孔(TSV)、系统级芯片封装(SoC)、扇出型封装(Fan-out)等形式的集成电路封装技术不断涌现,并应用于消费电子、工业控制、车载电子等终端应用场景。

报告期内,公司主要提供显示驱动芯片全制程封装测试统包服务,在封测业务制程方面,公司主营业务收入一般按照凸块制造(Bumping)、晶圆测试(CP)、玻璃覆晶封装(COG)和薄膜覆晶封装(COF)四大制程进行划分;按照所封测芯片的细分类型,主要分为LCD面板显示驱动芯片(DDI)、触控与显示驱动集成芯片(TDDI)、AMOLED面板显示驱动芯片等;按照终端应用场景,主要分为智能手机、高清电视、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴、汽车电子、电子标签等类别。公司显示驱动芯片封装测试制程服务具体情况如下:

工艺制程	具体介绍	功能特点	应用范围或领域
Bumping	凸块制造是指通过溅镀、曝光显影、电镀和蚀刻等制程,在晶圆的焊垫上制作凸块,可达到高效的电性传输,替代了传统封装中的导线键合。公司凸块制造工艺可实现凸块间最小间距最小至18μm,单片12吋晶圆上制造的千万颗凸块	通工艺可大幅缩小芯片模组的体积,具有密度大、散热佳、高可靠性等优点	主要应用于显示驱动芯片领域,适用于覆晶封装(FC)技术
CP	晶圆测试是指用探针与晶圆上的每个晶粒接触进行电气连接以检测其电气特性,对于检测不合格的晶粒用点墨进行标记,在切割环节被淘汰,不再进行下一个制程	通工艺不仅可以预测出合格的芯片,直接计算出良率,还可以减少后续不必要的操作,有效降低整体封装的成本	是大多数封装工艺必经的前道工序
COG	玻璃覆晶封装是指将芯片上的金凸块与玻璃基板上的引脚进行接合并利用胶质材料进行密封隔绝的技术,由于其广高良好稳定性,而被成熟应用于高清电视、手机等产品	是目前较为传统的屏幕封装工艺,也是最具性价比的解决方案,但由于芯片直接放置在玻璃基板上,占用较大空间,故屏占比不高	主要应用于小尺寸面板,如手机、平板电脑、数码相机等
COF	薄膜覆晶封装是指将芯片的凸块与卷带上的内引脚接合,之后由面板或模组厂商等将外引脚与玻璃基板接合	具有高密度、高可靠性、轻薄短小、可弯曲等优点,有利于缩小屏幕边框,提高屏占比	主要应用于电视等大尺寸面板和全面屏手机等

22、主要经营模式

1、盈利模式

公司属于集成电路行业的封装测试服务环节企业,采用行业惯用的OSAT(半导体封装测试外包)模式,在OSAT模式下,公司业务不涉及集成电路设计环节和晶圆制造环节,专门为集成电路设计公司提供封装测试服务。公司根据客户需求,通过工艺设计、利用封装测试设备、自行购买封装测试原辅料,对客户提供的晶圆进行凸块制造、晶圆测试、研磨、切割、封装等一系列的定制化精密加工及成品测试服务。公司通过为客户提供服务并收取加工服务费的方式获取收入和利润。

2、采购模式

公司的采购模式为按需采购,由物料采购部门统计生产有关的物料耗材需求并编制需求单,根据需求单向供应商下达采购订单并签约。对于主要采购材料,公司一般会与供应商签订框架协议,约定年度协议价格的测试价比例、单价、付款方式等。采购材料根据合同要求付款,由采购部门根据合同记录的付款申请单、经系统签核后,到期支付款项。采购材料到货后由相关部门进行验收,品质部顺次对应商提供的出货检测报告后进行分类抽检,检验合格后在系统中制作验收单,经系统签核后确认收货。

公司建立了供应商认证准入机制和考核机制,以保证供应质量及供应稳定性。公司仅向评估合格的供应商进行采购,评估内容包括供应商资质、材料质量、采购效率等,并且在采购的过程中持续考核其产品质量及服务等方面,对质量问题实时反馈并要求整改。

3、生产模式

公司目前采用行业普遍的“客户定制,以销定产”受托加工生产模式,即由客户提出需求并提供晶圆、卷带等制造材料,公司自行外购电镀液、金属靶材等封装测试辅料,按着相关客户需求完成相应工艺制程,而后将成品交付给客户或指定客户。

公司专注于提供高端封装和测试服务,拥有专业的工程技术和生产管理团队,并配备了专业的高精度自动化生产设备,可以为客户提供多样化、针对性、差异化又性价比的封装测试服务。

4、销售模式

公司采用直销模式进行销售,并制定了相应的销售管理制度。

作为集成电路封装测试企业,公司需要对客户技术需求进行工艺验证,验证通过后方能与客户开始合作。公司在获取客户具体订单后完成封装测试服务,并按照客户要求提供交付物,公司根据客户要求的付款条件定期开具的结算单,并在约定的付款时间内完成结算。

基于定制化的受托加工模式,公司的销售定价主要由自行采购的材料成本以及根据客户对工艺的要求协商达成的加工服务费共同构成。由于每个客户的芯片封装测试方案都具有定制化、个性化的特点,通常情况下,公司单独报价,而公司在报价时需结合并结合市场供需行情等因素予,与客户协商确定。后续在合作期客户可向公司下达需求订单以调整。

凸块制造的定价基于耗用的原材料成本及相应的加工服务费确定,晶圆测试、玻璃覆晶封装与薄膜覆晶封装主要基于不同芯片的具体工艺要求,综合考虑加工设备类型、加工时长及功能测试需行情的供求下,与客户协商确定。

5、研发模式

公司主要通过自主研发的模式持续对先进封装测试工艺进行研发活动,存实已有技术基础的同时进一步提高技术壁垒,并保障研发项目成功投产转化。

公司主要基于客户需求及技术方案的最新趋势,进行相应的研发投入,公司制定的研发流程主要包括项目调研、项目立项、工艺设计与开发、样品试制和研发结项等阶段,具体情况如下:

(1)项目调研

公司的研发项目主要来源于以下渠道:一是研发中心会定期调研行业发展趋势,结合公司发展规划及现有技术基础,选择相似的新技术、新工艺的研发立项;二是业务营销部在市场开拓过程中会有意收集客户需求信息,形成对市场需求的综合判断,针对市场需求集中的新产品提出立项建议。

(2)项目立项

研发中心在项目调研或收到立项建议后,将先进行初步论证,如初步论证可行,则会公司分管理层共同讨论立项提议,根据下发产品、工艺的技术指标、技术难点、成本效益等内容进行评估,确定具体研发内容,进而对资源配置、执行周期、项目人员等进行部署,形成研发项目立项书后正式启动项目研发工作。

(3)工艺设计与开发

公司根据项目立项书及技术可行性分析的要求,开展设计开发工作。由研发中心设立专项课题小组,积极调动各种资源以配合专项课题小组的活动。工艺设计开发流程,将召开评审会议,对项目取得的研发成果予以评定。专项课题小组根据会议评审结果,对项目设计与开发方案予以进一步修改,完善,并及时反馈给研发中心相关负责人。

(4)样品试制

专项课题小组会同生产制造部根据评审会议确定的技术参数和开发方案进行样品试制,专项课题小组辅以监督和技术指导,试制完成的样品品质保障部进行质量检测,并提交给研发中心相关负责人。

(5)研发结项

在验证合格后,研发中心将召开项目评审会,对样品的性能参数予以全面评估。评审会通过专项课题小组提交研发结项报告,项目研发工作结束。

23、所处行业情况

1、行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)所处行业

公司主营业务为集成电路的封装测试,根据《国民经济行业分类》(GB/4754-2017),公司属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”之“C3973 集成电路制造业